



(주)다원넥스뷰 IR정보

배포 일자 : 2026년 05월 08일

자료 문의 : 다원넥스뷰 경영지원실 031-8085-7899

다원넥스뷰, 114억 규모 프로브카드 본딩 장비 공급계약 체결

- 국내 주요 부품사와 pLSMB HSB 대규모 공급 계약, 2025년 매출 대비 42% 규모
- 글로벌 반도체 공급망 핵심 장비사로 도약 가속화
- AI 반도체·HBM·패키징·차세대 태양광까지 중장기 성장동력 본격화

초정밀 레이저 접합 장비 전문기업 다원넥스뷰가 5월 8일 국내 주요 프로브카드(Probe Card) 제조사와 114억 원 규모의 pLSMB HSB(High Speed Bonder) 공급계약을 공시하며 2026년 실적 성장 기대감을 높였습니다. 이번 계약은 2025년 매출 대비 약 42%에 해당하는 대형 수주로, 계약 기간은 2026년 10월까지입니다.

이번 수주는 단순한 매출 확대를 넘어 다원넥스뷰의 고속·고정밀 본딩 장비가 글로벌 반도체 공급망의 핵심 생산장비로 자리매김하고 있음을 보여주는 성과로 평가됩니다. 특히 AI 반도체와 HBM(고대역폭메모리) 시장 성장으로 프로브카드 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 고속·고정밀·양산 대응력을 동시에 갖춘 장비 공급사는 제한적입니다. 다원넥스뷰는 검증된 기술력과 국내외 고객 레퍼런스를 바탕으로 글로벌 시장 점유율 확대에 속도를 내고 있습니다.

특히 이번 수주는 글로벌 메모리 반도체 고객사의 증설 및 공급 확대 수요에 대응하기 위한 프로젝트라는 점에서 의미가 큼니다. 기존 아시아 중심의 고객 기반에서 북미 주요 반도체 밸류체인으로 고객 영역이 확대되며, 글로벌 고객 포트폴리오 다변화가 본격적으로 진행되고 있다는 평가입니다.

다원넥스뷰는 2024년 187억 원, 2025년 269억 원의 매출 실적을 기록한 데 이어, 2026년에는 연이은 대형 수주 성과와 생산능력 확대를 기반으로 또 한 번의 쿼텀 점프가 기대되는 국면에 진입했습니다.

회사는 2025년 어닝 서프라이즈 수준의 실적 발표와 2026년 2월 수주 공시에 이어, 2026년 4월 본점 소재지 이전을 통해 생산공간 확충과 독립 경영 체제 강화에 나선 바 있습니다. 증가하는 고객 수요에 대응하기 위한 선제적 투자로, 추가 생산 인프라 확대도 검토 중입니다. 이는 향후 매출 성장과 수익성 개선의 기반이 될 전망입니다.

주력 사업의 안정적 성장과 함께 신규 사업 확장도 본격화되고 있습니다. 반도체 패키징 분야에서는 글로벌 고객사 공급망 진입을 기반으로 추가 수주가 기대되며, 태양광 부문 역시 차세대 고효율 기술인 페로브스카이트 태양전지 장비 납품 실적을 확보하며 중장기 성장동력으로 부상하고 있습니다.

다원넥스뷰 관계자는 “이번 계약은 글로벌 시장 확대의 출발점에 불과하다”며 “검증된 초정밀 레이저 접합 기술력을 기반으로 반도체와 미래 에너지 산업 전반에서 글로벌 경쟁력을 지속적으로 확대해 나가겠다.”고 밝혔습니다.

[다원넥스뷰 CI]

